

证券简称：灿芯股份

证券代码：688691

灿芯半导体（上海）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称	汇添富基金、富国基金、国联安基金、兴证全球基金、泰康资产、固禾基金、西部证券、开域投资、磐厚资产、上善如是私募基金、钦沐资产、国泰海通证券、东方基金、中信建投证券、国海证券、中海基金、申万宏源证券、中信证券、招商证券、华泰证券、开源证券、宁银理财、兴业基金、国信证券、华夏基金、浙商资管、上海证券、惠升基金、中邮证券、民生基金、华安证券、凯石基金、国泰基金、中泰证券、长江养老、万家基金、坤阳投资、高毅资产、富达国际、永赢基金、中和资本、华泰柏瑞、常春藤资产、山西证券、百年保险、中信保诚基金、浩期资产、天弘基金
时间	2025 年 5 月 16 日
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理庄志青先生 董事会秘书沈文萍女士 证券事务代表石啸天、梁砚卿
投资者关系 活动主要内容 介绍	公司情况简要介绍： 灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型 SoC 定制设计技术与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系。 依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市等行业。 2024 年度，公司实现营业收入 108,966.12 万元，归属于母公司所有者

的净利润 6,104.72 万元。

投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：

1、公司 2024 年度在芯片设计项目方面取得了哪些进展？

答：2024 年度，公司持续深耕主营业务，完成了多个代表性芯片设计项目，包括高性能工业控制芯片、通讯基带芯片、物联网通信芯片、磁容触控双模芯片等，上述芯片基于国产自主工艺，部分芯片内嵌 RISC-V 核及多个由公司自主研发的 IP，进一步证明了公司在一站式芯片定制服务领域的技术能力与市场地位。

2、公司 2024 年度在研发方面的进展情况？

答：2024 年度，公司主要研发主要进展如下：

（1）高速接口 IP 领域：①DDR：公司基于 28nmHKC+工艺的 72bitDDR、LPDDRIP 设计验证成功，最高速率达到 2,667Mbps；基于 28nmHKD2.5V 工艺的 DDR、LPDDRIP 设计验证成功；基于 28nmHKD1.8V 工艺的 DDR、LPDDRIP 设计完成进入验证阶段。②Serdes 与 PCIE：公司基于 28nmHKC+工艺的 SerdesIP 及 PCIEIP 设计验证成功，最高速率可达到 16Gbps，并实现量产交付。③MIPI：公司可满足汽车电子可靠性要求的先进工艺 MIPIDPHYIP 设计验证成功，最高速率可达 2.5Gbps，同时公司基于 28nmHKC+工艺的 MIPIDPHYIP 设计验证成功，最高速率可达 4.5Gbps；④USB：公司可满足汽车电子可靠性要求的先进工艺 USB2.0IP 设计验证成功，速率可达 480Mbps。同时公司基于 28nmHKD1.8V 工艺的 USB2.0IP 以及基于 28nmHKD2.5V 工艺的 USB2.0IP 设计验证成功，并实现客户交付。⑤PSRAM：公司基于 28nmHKD2.5V 工艺的 PSRAMIP 设计完成进入验证阶段。⑥EMMC：公司基于 28nmHKD2.5V 工艺的 EMMCIP 设计完成进入验证阶段。

（2）高性能模拟 IP 领域：①ADC：公司 40nmLL 工艺 16bitSARADCIP 设计验证成功，最高采样率达到 4Msps，有效位达到 14bit 以上；基于 28nmHKD1.8/2.5V 工艺的高速 ADC 设计完成进入验证阶段。②PLL：公司 28nmHKC+工艺 PLLIP 设计验证成功，最高速率达到 4.5GHz；同期公司 28nmHKD1.8V 工艺 PLLIP 设计完成进入验证阶段以及基于 28nmHKD2.5V 工艺 PLLIP 设计完成进入验证阶段。

（3）系统级芯片平台研发领域：①车规平台方面：公司基于

40nmEFlash 的车规双核锁步 MCU 平台已目前完成 IP 以及前后端设计的主体设计，并进入后仿验证阶段；②端侧 AI 平台方面：公司基于 28nm 工艺实现 AIISP、大小核 CPU、NOC 总线、高速 Serdes 接口等集成，目前已完成前端设计，并进入 FPGA 验证和数字仿真验证阶段。③自动测试平台方面：公司已分别实现 MIPI、PCIE、DDR、ADC、RF 的自动化测试系统搭建，并在实际项目中得以应用验证，测试数据的一致性有保证，测试效率大幅度提高。

3、公司 2024 年度营业收入变动的原因？

答：公司持续专注于为客户提供高价值、差异化的一站式芯片定制服务，受下游客户终端市场需求变动及项目执行情况等因素影响，公司 2024 年度营业收入有所下降，在公司主营业务毛利率基本稳定的情况下，对本年度利润产生一定影响。具体而言，在芯片设计业务方面，受本年度芯片设计项目体量整体而言较上一年度有所下降等因素影响，公司芯片设计业务收入规模有所下降。尽管如此，公司本年度芯片设计业务整体发展情况良好，完成流片验证的项目数量为 190 个，较上一年度增长超过 30%。在芯片量产业务方面，主要因部分客户终端市场需求变动影响，公司芯片量产业务收入规模有所下降。目前该客户的终端市场需求有所回暖，其对公司的采购亦逐步恢复。

4、公司目前新业务和新技术布局情况是怎样的？

答：2024 年度，公司在持续深耕现有核心业务领域的同时积极布局新的技术方向及应用场景，并在 ISP、车规 MCU、Wi-Fi+BLECombo、ADC 等领域进行了深入的技术研发工作。

在 ISP 方面，公司基于自身积累的已有 ISP 领域相关技术经验，持续进行研发投入，对现有的 ISP 方案进行了升级优化，包括优化内部 LDO、降低不同工作模式下电源消耗等。同时，公司通过优化红外图像处理等算法、提升图像处理能力等途径使得公司的 ISP 相关技术能够进一步满足安防、监控、智慧城市、智能家电等多样化的应用需求。

在车规 MCU 方面，公司已经获得 ISO26262 汽车功能安全管理体系认证，在车规 MCU 领域研发的芯片样片已进入流片阶段，同时公司多款 IP 产品目前也在进行车规级认证，公司已与车规 MCU 及车规 IP 领域的一系列客户开展了合作接洽。

此外，公司在 Wi-Fi+BLECombo、ADC 等方面取得了积极进展。

5、公司的研发投入情况及后续的研发规划是怎样的？

答：2024 年度，公司研发投入金额为 1.28 亿元，研发投入比例达到 11.73%。截至 2024 年末，公司共有研发人员 155 人，较去年同期末增加 45 人，研发人员占比达到 45.32%。研发人员中，硕士及以上学历 93 人，占研发人员总数的 60.00%。公司未来将根据自身战略进行研发布局，始终重视研发投入及研发团队建设，持续提高公司竞争力。

6、公司 2025 年第一季度的经营情况如何？

答：2025 年第一季度，受公司下游客户需求波动影响，公司营业收入同比下降 59.23%，同时受研发技术人员费用支出较为刚性等因素影响，导致公司本季度出现亏损。截至 2025 年 3 月 31 日，公司在手订单 8.99 亿元，其中设计业务在手订单 3.40 亿元，量产业务在手订单 5.59 亿元。公司截至 2025 年第一季度末的在手订单金额环比增长 11.38%，呈现回升态势，为公司后续业务发展奠定良好基础。公司截至 2025 年一季度末的合同负债环比增长 40.91%，均为公司一站式芯片定制服务业务的预收款。

截至 2025 年第一季度末，公司在手订单环比回升，多个新项目进入设计阶段并有望在本年度内流片，同时公司积极拓展新业务领域，在车规级芯片平台、高速接口 IP 及高性能模拟 IP 的研发方面取得积极进展，公司目前主营业务发展情况整体良好。

7、公司对未来发展的展望？

答：公司将继续专注于为客户提供一站式芯片定制服务，致力于为客户提供高价值、差异化的解决方案。凭借成熟的行业应用解决方案、优秀的芯片架构设计能力和丰富的芯片设计经验，帮助客户高效率、高质量完成芯片的定义、设计和量产出货。公司后续主要经营计划包括：

（1）技术研发创新：公司将进一步加大研发投入，提升自主创新能力、完善研发体系与质量管理体系，对现有的以大型 SoC 定制设计技术与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系进行持续研发，不断为客户提供高质量、高效率、低成本、低风险的一站式芯片定制服务。

（2）市场拓展：一方面，公司将加强市场开拓力度，重点布局汽车电子、端侧 AI、AI+IoT 等高潜力领域，加速技术研发成果的市场化应用，增强公司核心竞争力；另一方面，公司将拓展销售与服务网络的覆盖度，提升销售团队整体专业素质，优化公司营销模式。

	（3）研发团队建设与管理效能提升：公司重视人才引进，立足公司实际情况，积极同国内外科研院所、高校和企业进行交流，注重国内外高端专业技术人才的引进。与此同时，公司实施人才培养计划，健全公司内部培训、人员考核评价、晋升及优化机制，加强公司在创新文化、员工职业生涯规划、内部知识共享、员工领导能力建设方面的投入，持续提升员工队伍素质。此外，公司还将优化管理流程，提升流程效率，优化整体管理效能，降低公司运营成本 （4）并购重组与资源整合：在高度竞争的产业形势下，公司将在自身成长的同时，积极寻求并购机会，从而使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。公司将综合评估标的公司的管理团队和企业文化与公司的兼容性，保障公司核心竞争力的加强和进一步发展。
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 16 日
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无